

PRO系列

2026

—

紧凑型高精度
3D成像模组



PRO系列2026

紧凑型高精度3D成像模组

PRO S

PRO S Enhanced

轻量级设计

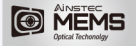
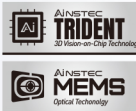
高精度点云表现

高性能边缘计算模块

高可靠性和稳定性

高分辨率 SONY RGB CMOS

专业ISP调优



		PRO S	PRO S Enhanced
基本参数	尺寸: mm(L*W*H)	165*115*49	165*115*49
	重量: kg	1.03	1.03
	基线: mm	125	125
工作视场	推荐工作距离: mm	400~700	380~1000
	近视场: mm (typ)	400*350@400	300*250@380
	远视场: mm (typ)	700*620@700	650*640@1000
	彩色相机	H:66/V:53.6	H:56.8/V:44.7
精度	垂直 (Z)	< 0.1%	< 0.1%
	水平 (X/Y)	< 0.2%	< 0.2%
	点间距: mm	0.35@500	0.25@500
分辨率	深度	1600*1200	1600*1200
	彩色	3600*2800	3000*2280
采集时间	典型采集时间: s	0.7~1.1s	0.7~1.1s
API	应用程序接口	C++, C#, Python、Halcon	C++, C#, Python、Halcon
操作系统支持	微软操作系统	Windows 10/11	Windows 10/11
	LINUX操作系统	Ubuntu 16.04/18.04/20.04	Ubuntu 16.04/18.04/20.04
硬件接口	电源接口	POE IEEE 802.3at	POE IEEE 802.3at
	以太网口	M12 X-CODE, GigE, IFFF 1588	M12 X-CODE, GigE, IFFF 1588
环境参数	工作温度	0~40℃	0~40℃
	存储温度	-20~70℃	-20~70℃
	湿度	20%~80% RH无凝结	20%~80% RH无凝结
	防护等级	IP65	IP65
认证	认证	CE, FCC	CE, FCC
供电	外部直流供电	/	/
	电源输入	POE	POE
	功耗: W (typ)	16W	16W

